

Подготовка платы к пайке.

Автор:

04.04.2007 18:54 -

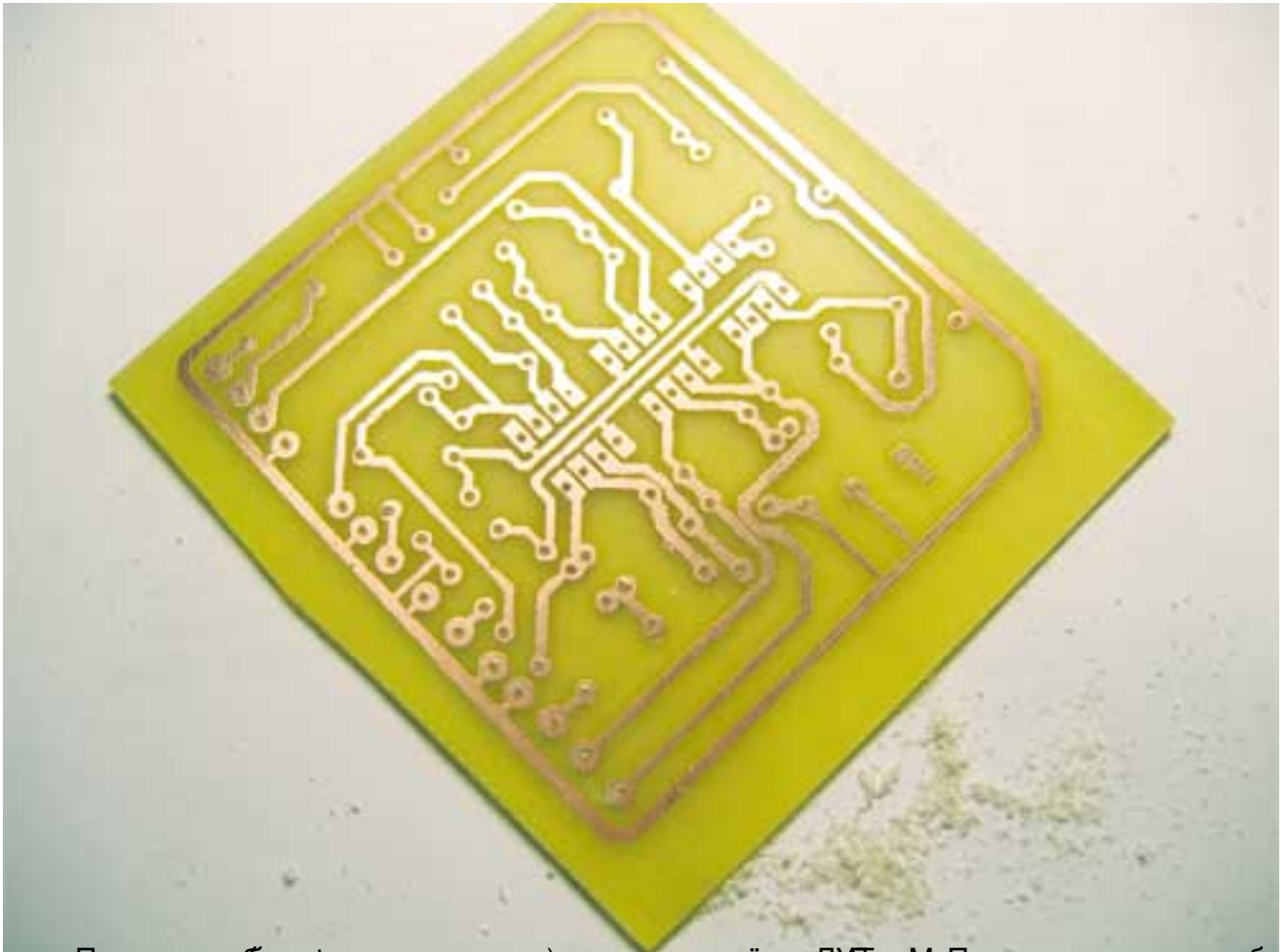
После того как мы вытравили плату нам нужно проделать ещё несколько несложных манипуляций чтобы подготовить её к пайке. Прежде всего нам необходимо высверлить отверстия для монтажа радиоэлементов. Как правило сам рисунок вытравленной платы подсказывает нам где в плате должны быть отверстия. Берём лёгкую дрель - в идеале минидрель как раз предназначенную для высверловки небольших отверстий. Использовать большую дрель-перфоратор не советую - будет сложно зафиксировать дрель, плату, дрель тяжёлая а свёрла очень тонкие - будут ломаться на раз. Как компромиссный вариант - существуют специальные насадки на обычные дрели (по типу бор машины) - но удобство и такого варианта у меня вызывает сомнения. Для высверловки отверстий под обычные маломощные резисторы, конденсаторы, микросхемы применяют обычно свёрла диаметром 0.8 - 0.9 мм. Для более толстых выводов диодов, мостов, высоковольтных конденсаторов от 1.0 мм и больше. Такие же свёрла подойдёт для высверловки отверстий для монтажного провода. Отверстия под панельки для радиоламп сверлим соответственно более толстым сверлом (1.5-2.5 мм). Самым толстым сверлом - 3мм - высверливаем вспомогательные отверстия в плате - под болты крепежа платы к корпусу.



Стеклотекстолит достаточно плотный материал - свёрла быстро тупятся но и стоят не так дорого. Я предпочитаю купить новое сверло чем мучиться высверливая одно отверстие по 5 минут. :) Сверлить стараемся аккуратно, дрель ставим перпендикулярно плате - чтобы отверстия не получались под углом. Стеклотекстолитовую пыль не вдыхаем - говорят - вредная штука. :)

Подготовка платы к пайке.

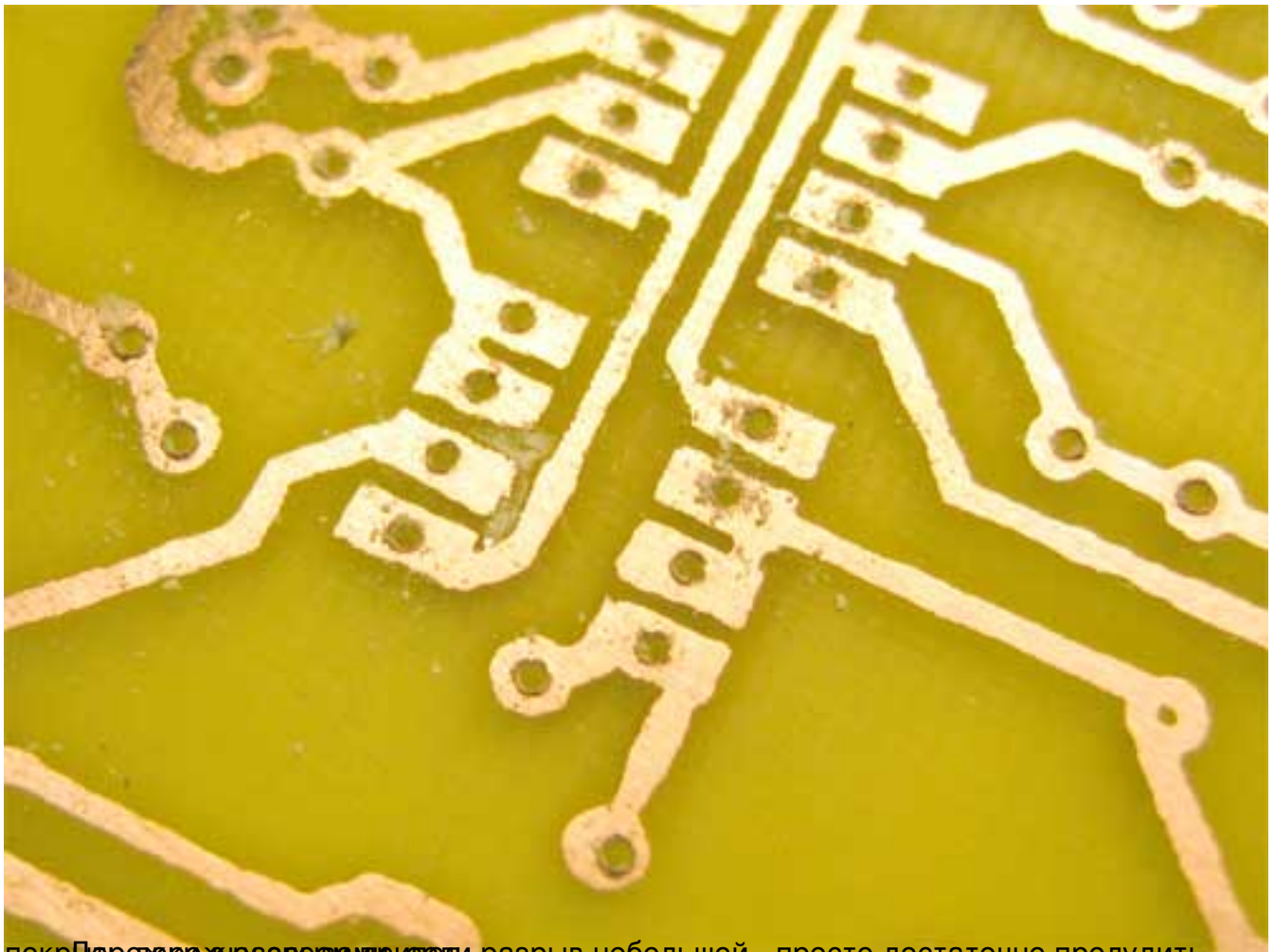
Автор:
04.04.2007 18:54 -



в р о д у к ц и о н н о м б и з н е с е (в о з м о ж н о с т ь) п о л н о с т ь ю (с о с т а в) б л о к и б л о к и в с е р ь е з н ы м с

Подготовка платы к пайке.

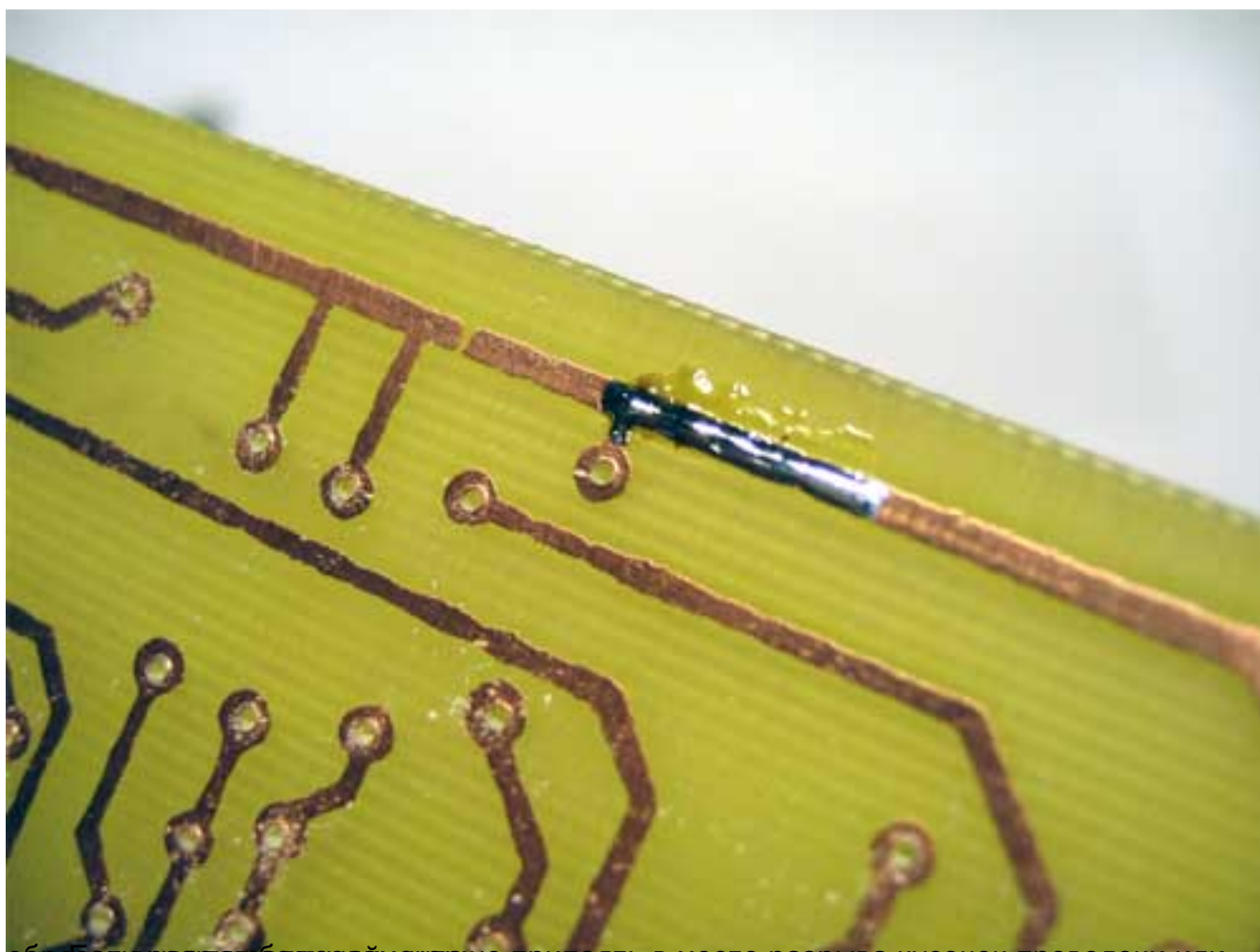
Автор:
04.04.2007 18:54 -



пкрдор дорож разрывам и если разрыв небольшой - просто достаточно пролудить -

Подготовка платы к пайке.

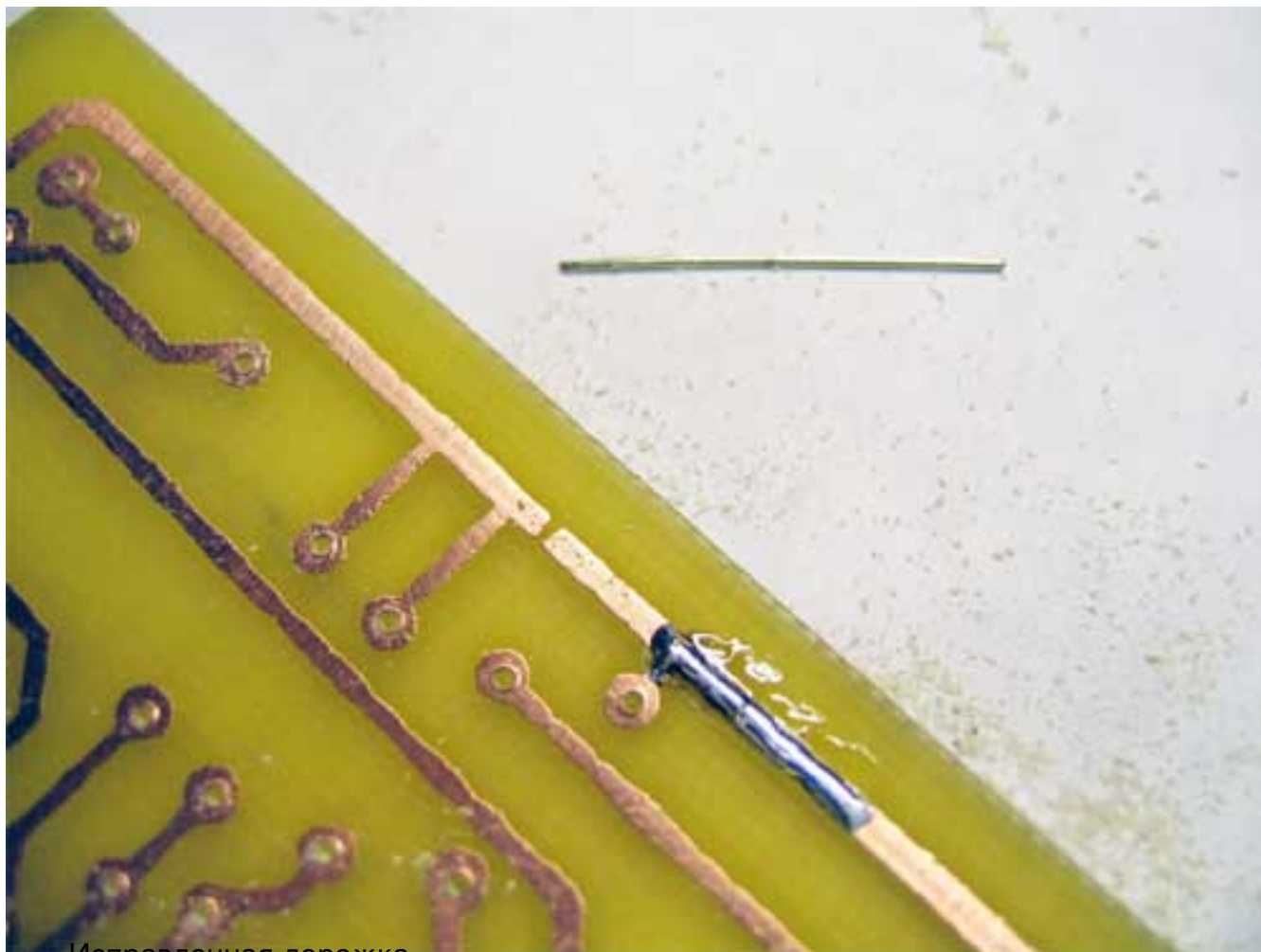
Автор:
04.04.2007 18:54 -



образовывающемся в месте разрыва можно припаять в место разрыва кусочек проволоки или

Подготовка платы к пайке.

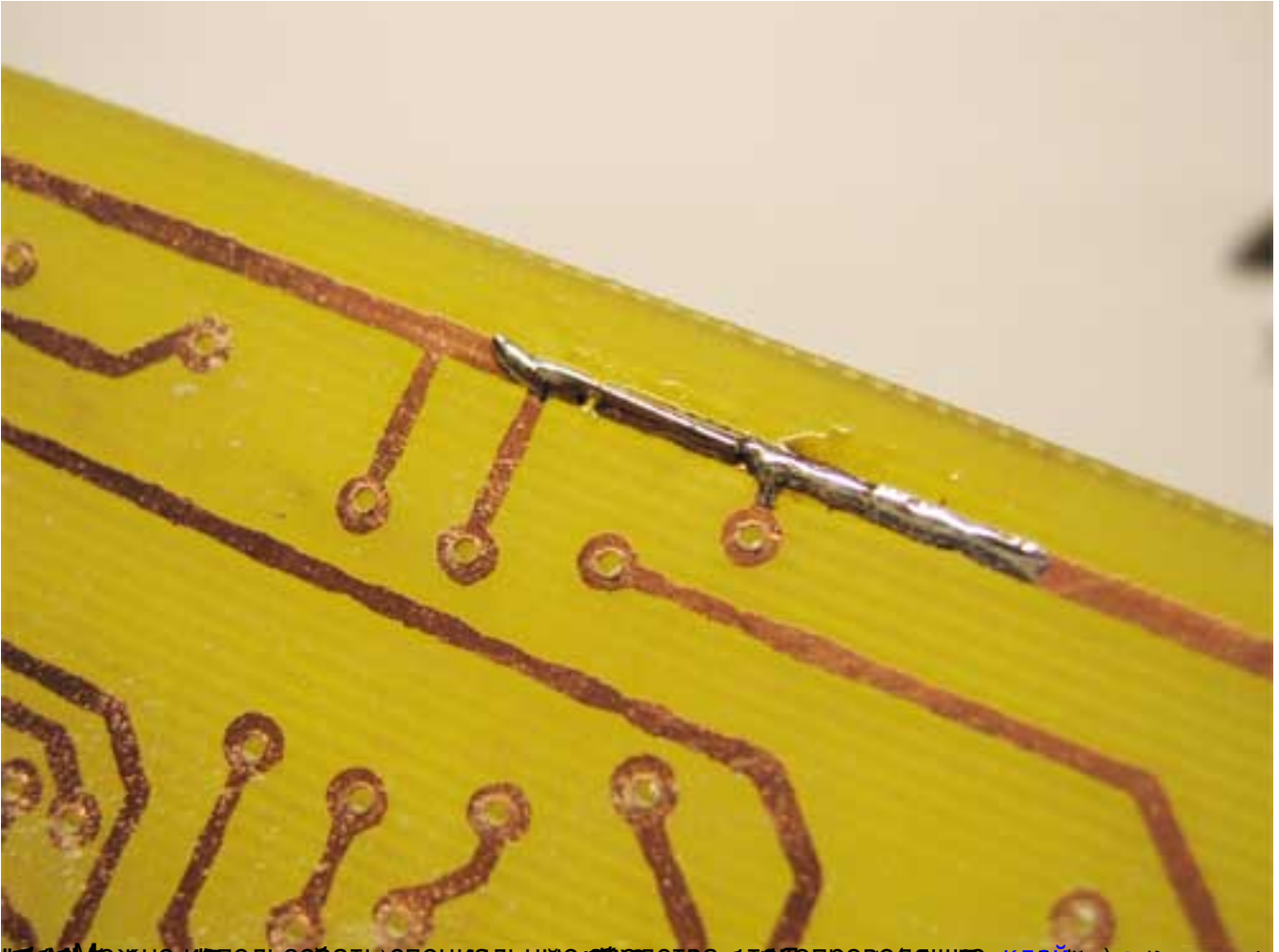
Автор:
04.04.2007 18:54 -



Исправленная дорожка.

Подготовка платы к пайке.

Автор:
04.04.2007 18:54 -



~~Секретная информация. Использование в сети и на других ресурсах без разрешения администрации сайта запрещено.~~